

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本文件全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



SEMICONDUCTOR MANUFACTURING INTERNATIONAL CORPORATION

中芯國際集成電路製造有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0981)

### 中芯截至二零零九年九月三十日止三個月業績公佈

- 國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司（紐約交易所：SMI；香港聯交所：981）（「中芯」或「本公司」）於今日公佈截至二零零九年九月三十日止三個月的綜合經營業績。
- 二零零九年第三季的總銷售額由二零零九年第二季的 267,400,000 元上升 20.9% 至 323,400,000 元，與二零零八年第三季相比下降 14.0%。65 納米產品按計劃量產並且我們預期 65 納米產品的出貨量將在二零零九年第四季及二零一零年進一步增加。大中國區的晶圓收入季度成長 33.5%。二零零九年第三季的毛利率由二零零九年第二季的-4.8%改善至 0.8%主要由於晶圓出貨量和產能利用率增加所致。二零零九年第三季來自於經營活動的現金淨額由二零零九年第二季的 43,200,000 元大幅增加至 73,000,000 元。二零零九年第三季普通股持有人應佔虧損為 69,300,000 元，二零零九年第二季普通股持有人應佔虧損為 98,200,000 元。每股美國預托股股份淨虧損（攤薄）為 0.1550 元。
- 以下為本公司於二零零九年十月二十八日就截至二零零九年九月三十日止三個月的未經審核業績公佈全文。
- 本公司根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.09(1) 條規定的披露責任於二零零九年十月二十八日作出本公佈。

以下為本公司於二零零九年十月二十八日就截至二零零九年九月三十日止三個月的未經審核業績公佈全文。

所有貨幣數位主要以美元列賬，除非特別指明。

報告內的財務報表數額按美國公認會計原則厘定。

中國上海—二零零九年十月二十八日—國際主要半導體代工製造商中芯國際集成電路製造有限公司（紐約交易所：SMI；香港聯交所：981）（「中芯」或「本公司」）於今日公佈截至二零零九年九月三十日止三個月的綜合經營業績。

## 二零零九年第三季概要

- 二零零九年第三季的總銷售額由二零零九年第二季的 267,400,000 元上升 20.9%至 323,400,000 元，與二零零八年第三季相比下降 14.0%。
- 65 納米產品按計劃量產並且我們預期 65 納米產品的出貨量將在二零零九年第四季及二零一零年進一步增加。
- 大中國區的晶圓收入季度成長 33.5%。
- 二零零九年第三季的毛利率由二零零九年第二季的-4.8%改善至 0.8%主要由於晶圓出貨量和產能利用率增加所致。
- 二零零九年第三季來自於經營活動的現金淨額由二零零九年第二季的 43,200,000 元大幅增加增加至 73,000,000 元。
- 二零零九年第三季普通股持有人應佔虧損為 69,300,000 元，二零零九年第二季普通股持有人應佔虧損為 98,200,000 元。
- 每股美國預托股份淨虧損（攤薄）為 0.1550 元。

## 二零零九年第四季指引

以下聲明為前瞻性陳述，此陳述基於目前的期望並涵蓋風險和不確定性，部分已於之後的安全港聲明中闡明。

- 二零零九年第四季收入預期按季增加 2%至 5%。
- 經營開支去除匯兌損益預期介於 67,000,000 元至 72,000,000 元之間。
- 資本支出預期介於 90,000,000 元至 95,000,000 元之間。
- 折舊及攤銷預期約為 193,000,000 元。

---

在談論該季度業績時，中芯國際首席執行官張汝京博士表示：「2009 年第三季度繼續展示了晶圓代工市場的復甦。中芯國際於 2009 年第三季度的收入較上一季度增長約 21%，超過了原先的季度預期；此外，我們預計 2009 年第四季度收入將按季度繼續增加 2%至 5%。而第三季度的產能利用率達 87.3%，較第二季度的 75.4%為高；而消費品類別出現顯著的季度增長，銷售較上一季度增加 40.6%。

從區域來看，相對上一季度，大中華地區的收入增長了 33.5%，北美地區的收入增長了 16.7%，而歐洲地區的收入則增長了 3%。北美仍然是中芯國際的最大收入貢獻來源及在先進制程上錄得強勁收入增長的地區。而 2009 年第三季度來自大中華的收入貢獻上升至佔總收入的 36.6%，相比 2009 年第二季度佔總收入的 33.2%及 2008 年第三季度佔總收入的 31.2%為高。在 2009 年第三季度，80%的新客戶均來自大中華地區。

我們正在優化集團的產品組合，亦正在加快先進制程的發展。基於銷售額的分佈從 0.18 微米及以上轉移到 0.13 微米及以下，我們看到市場正邁向先進產品。我們 0.13 微米及以下晶圓佔 2009 年第三季度晶圓總收入達到 52.8%，相比 2009 年第二季度的 46.4%為高。在先進技術發

展方面，我們的 65 納米產品正按計劃量產，而我們的 65 納米低漏電工藝標準單元庫和關鍵 IP 庫亦已就緒，我們期望在 2009 年第四季度和 2010 年繼續擴充 65 納米產品的出貨量。此外，我們 45 納米的發展比預期迅速，而我們與數個客戶合作的產品均正處於不同的認證階段，我們預期第一個 45 納米的產品將在今年年底流片。目前，我們提供的完整先進產品制程至 40 納米，而我們最近亦宣布了將技術擴展至 55 納米。此外，我們已和合作夥伴及客戶開展了 32 納米產品的合作，現正處於研發階段。

展望 2009 年第四季度，我們預期收入提高使毛利有所增長，而且先進制程（包括 90 納米和 65 納米產品）的收入亦將明顯增加。由於大部分上海 8 英寸晶圓廠的機台折舊已完成，總折舊和攤銷費用預計到 2010 將按年顯著下降。我們會繼續嚴謹控制成本，並期望我們本年度的全年資本開支維持在 1.9 億元左右。

總結，我們將繼續通過改善產品組合、發展先進技術制程和嚴控資本支出，以努力實現我們的盈利目標。」

---

## 電話會議／網上業績公佈詳情

日期：二零零九年十月二十九日

時間：上海時間上午八時三十分

撥號及登入密碼：美國 1-617-614-3672 / 1-800-260-8140(密碼：SMIC)或香港 852-3002-1672  
(密碼：SMIC)

二零零九年第三季業績公佈網上直播可於 [www.smics.com](http://www.smics.com) 網站「投資者關係」一欄收聽。中芯網站在網上廣播後為期十二個月提供網上廣播錄音版本連同本新聞發佈的軟拷貝。

---

## 關於中芯國際

中芯國際集成電路製造有限公司（“中芯國際”，紐約證交所股票代碼：SMI，香港聯合交易所股票代碼：981），是世界領先的集成電路晶片代工企業之一，也是中國內地規模最大、技術最先進的集成電路晶片代工企業。中芯國際向全球客戶提供 0.35 微米到 45 納米晶片代工與技術服務。中芯國際總部位於上海，在上海建有一座 300mm 晶片廠和三座 200mm 晶片廠。在北京建有兩座 300mm 晶片廠，在天津建有一座 200mm 晶片廠，在深圳有一座 200mm 晶片廠在興建中，在成都擁有一座封裝測試廠。中芯國際還在美國、歐洲、日本提供客戶服務和設立營銷辦事處，同時在香港設立了代表處。此外，中芯代成都成芯半導體製造有限公司經營管理一座 200mm 晶片廠，也代武漢新芯集成電路製造有限公司經營管理一座 300mm 晶片廠。

詳細資訊請參考中芯國際網站<http://www.smics.com>

## 安全港聲明

(根據 1995 私人有價證券訴訟改革法案)

本次新聞發佈可能載有(除歷史資料外)依據 1995 美國私人有價證券訴訟改革法案的“安全港”條文所界定的「前瞻性陳述」。該等前瞻性陳述,包括有關我們對對市場正邁向先進產品的期望、在二零零九年第四季度和二零一零年繼續擴充 65 納米產品出貨量的期望、45 納米產品將在今年年底流片的目標、我們就二零零九年資本支出的期望、我們就二零零九年及二零一零年的總折舊和攤銷費用總額的期望,以及在“折舊和攤銷”,“資本开支概要”和“二零零九年第四季度指引”等聲明乃根據中芯對未來事件的現行假設、期望及預測而作出。中芯使用「相信」、「預期」、「打算」、「估計」、「期望」、「預測」或類似的用語來標識前瞻性陳述,儘管並非所有前瞻性聲明都包含這些用語。該等前瞻性陳述乃反映中芯高級管理層根據最佳判斷作出的估計,存在重大已知及未知風險、不確定性,以及其他可能導致中芯實際業績、財政狀況或經營結果與前瞻性陳述所載資料存在重大差異的因素,包括(但不限於)與半導體行業周期及市場狀況有關的風險、全球經濟衰退及其對中國經濟的影響、激烈競爭、中芯客戶能否及時接收晶圓產品、能否及時引進新技術、中芯抓住在中國發展機遇的能力、中芯於加強全面產品組合的能力、半導體代工服務供求情況、行業產能過剩、設備、零件及原材料短缺、未決訴訟的頒令或判決、能否取得生產力,和終端市場的財政穩定。

投資者應考慮中芯呈交予美國證券交易委員會(「證交會」)的文件資料,包括其於二零零九年六月二十二日以 20-F 表格形式呈交給證交會的年報,特別是在「風險因素」和「管理層對財務狀況和經營業績的討論與分析」部分,並中芯不時向證交會(包括以 6-K 表格形式),或聯交所呈交的其他文件。其他未知或不可預測的因素也可能對中芯的未來結果,業績或成就產生重大不利影響。鑒於這些風險,不確定性,假設及因素,本次新聞發佈中討論的前瞻性事件可能不會發生。請閣下審慎不要過分依賴這些前瞻性聲明,因其只於聲明當日有效,如果沒有標明聲明的日期,就截至本新聞發佈之日。除法律有所規定以外,中芯概不負責因新資料、未來事件或其他原因引起的任何情況,亦不擬更新任何前瞻性陳述。

---

## 重大訴訟

### 台積電法律訴訟之近期發展

二零零六年八月二十五日,台積電入稟加州阿拉米達郡最高法院,指稱本公司違反和解協定、違反承兌票據及挪用商業機密而對本公司及若干附屬公司(即中芯上海、中芯北京及中芯美國)提出訴訟。台積電要求(其中包括)損害賠償、禁制令、律師費及提早支付和解協定所規定的餘下未付金額。

當前訴訟中,台積電指稱本公司利用台積電之商業機密製造本公司 0.13 微米或以下制程產品,又指稱由於本公司違約,台積電之專利特許權已終止,而有關本公司較大制程產品的不起訴契諾亦已失效。本公司強烈否認所有關於挪用機密的指控。法院並無證據證明台積電之申索有效。法院已定二零零九年九月八日再審訊。

本公司於二零零六年九月十三日公佈，除強烈抗辯台積電在美國訴訟的指控外，亦已於二零零六年九月十二日反訴台積電，就（其中包括）台積電違反合約及違反真實公平交易的推定契諾，要求台積電賠償損失。

中華人民共和國北京市高級人民法院於二零零六年十一月十六日受理本公司與本公司全資附屬公司中芯上海及中芯北京對台積電違反誠信原則、商業詆毀的不公平競爭行為提出的指控（「中國訴訟」）。在中國訴訟中，本公司要求（其中包括）判令台積電停止侵權行為、台積電向本公司公開道歉及賠償（包括台積電因侵權行為所獲利潤）。

二零零七年八月十四日，本公司修訂對台積電提出的反訴，要求（其中包括）台積電就違約及違反專利特許協定賠償。台積電隨後否認本公司經修訂反訴中的指控，並追加指控本公司向北京市高級人民法院起訴台積電乃違反和解協定。本公司否認台積電所追加的指控。

二零零七年八月十五日至十七日，加州法院就台積電申請臨時禁令禁止本公司的0.13微米邏輯晶圓制程採用若干加工技術進行聆訊。

二零零七年九月七日，法院拒絕台積電提出的臨時禁令申請，故此對本公司的業務發展及銷售並無影響。然而，法院要求本公司若計劃在若干情況下向非中芯國際機構披露邏輯晶圓技術時，須提前十天通知台積電，以便台積電可就該披露提出反對。

二零零八年五月，台積電就本公司的多項反訴向加州法院提交請求簡易判決的申請。本公司反對有關申請，而於二零零八年八月六日，法院決定部份批准並部份駁回台積電的申請。

二零零八年六月二十三日，本公司向加州法院反訴台積電，要求（其中包括）台積電就非法挪用中芯國際的商業機密以提升與中芯國際競爭的能力作出賠償。

二零零八年七月十日，加州法院就台積電申請臨時禁令禁止本公司向第三方披露有關0.30微米邏輯晶圓制程的若干制程技術資料進行聆訊。二零零八年八月八日，法院批准台積電提出的部分申請，臨時禁制本公司披露十四個0.30微米制程步驟。二零零八年十月三日，中芯國際就法院於二零零八年八月八日的判令向加州上訴法院提出上訴，上訴有待審理。

預審時，中芯國際與台積電簽定的二零零五年和解協定的實際條款出現爭議。因此，加州法院在審訊前於二零零九年一月十三至十六日進行初審，純為厘定和解協定的條款及詮釋任何須「會面商討」的規定。二零零九年三月十日，法院發佈決定聲明，決定雙方於二零零五年一月三十日簽署協定，其後在台積電強烈要求下於二零零五年二月二日修訂。本公司相信法院的裁決是錯誤的，法院就此作出最終判決後或會遭中芯國際上訴。

二零零九年五月一日，本公司就台積電指控本公司違反承兌票據及違反加州的統一商業機密法提出簡易判決的申請，法院於二零零九年七月二十日駁回此申請。

二零零九年五月一日，台積電就本公司的多項積極抗辯提出簡易判決的申請。法院已於二零零九年七月二十日批准台積電的部分申請。本公司相信法院批准台積電的部分申請有誤。法院作出相關的最終判決後或會遭中芯國際上訴。

二零零九年八月十日，台積電就其指控本公司故意銷毀與訴訟有關的若干文件證據提出制裁。法院作出裁定，本公司提出的商業機密反訴將分開審訊以容許恢復本公司的存檔備份檔案。並且，法庭已表示將指示陪審團：允許陪審團，但非強制陪審團，在證據丟失的基礎上在審訊中就若干問題針對本公司作出決定。本公司相信該裁定有誤。對該裁定的上訴只能在最終裁決時提出。

陪審團關於台積電若干商業機密訴訟的全部責任事宜的審訊已於二零零九年九月八日開始。預期陪審團將在二零零九年十一月呈遞結論。在本次審訊陪審團做出結論後，估計法庭將確定審訊本公司反訴台積電挪用商業機密的日期。

有關本公司於北京市高級人民法院的訟訴，在台積電提出上訴未果後，法院於二零零八年十月十五日、十月二十九日及十一月二十五日舉行聽證會。二零零九年六月十日法院作出一審判決，一審中法院沒有支援中芯國際對台積電的訟訴請求，中芯國際已就一審判決向中華人民共和國最高人民法院提出上訴。最高法院已將二審的第一次开庭定於2009年11月25日。

根據SFAS第144號的規定，本公司須決定該未決訟訴是否屬於需要進一步分析專利特許組合有否減值的事件。本公司認為，該法律訟訴現處於初步階段，故仍在評估訟訴是否屬於該類事件。本公司預期將獲得更多資料以助本公司作出決定。根據SFAS第144號進行的減值分析結果或會嚴重影響本公司財務狀況及經營業績。由於訟訴仍處於初步階段，本公司無法評估不利判決的可能性，亦無法評估可能損失的金額或範圍。

投資者聯絡資料：

En-Ling Feng

電話：+86-21-3861-0000，內線： 16275

[Enling\\_Feng@smics.com](mailto:Enling_Feng@smics.com)

Anne Wong Chen

電話：+86-21-3861-0000，內線： 12804

[Anne\\_CAYW@smics.com](mailto:Anne_CAYW@smics.com)

Edith Kwan

電話：+852-2116-2624

[Edith\\_Kwan@smics.com](mailto:Edith_Kwan@smics.com)

二零零九年第三季經營業績概要：

以千美元為單位（每股盈利和百分比除外）

	二零零九年 第三季度	二零零九年 第二季度	季度比較	二零零八年 第三季度	年度比較
銷售收入	323,356	267,422	20.9%	375,945	-14.0%
銷售成本	320,702	280,319	14.4%	348,720	-8.0%
毛利(虧損)	2,654	(12,897)	-	27,224	-90.3%
經營開支	99,184	81,606	21.5%	40,451	145.2%
經營虧損	(96,530)	(94,503)	2.1%	(13,227)	629.8%
其他費用，淨額	(3,943)	(5,802)	-32.0%	(15,631)	-74.8%
所得稅利益（支出）	31,704	2,880	1000.7%	(4,499)	-
稅後淨虧損	(68,769)	(97,425)	-29.4%	(33,357)	106.2%
應佔聯營公司虧損	(313)	(482)	-35.0%	(26)	1103.0%
淨虧損	(69,081)	(97,907)	-29.4%	(33,384)	106.9%
非控制權益持有人利息	(265)	(262)	1.2%	3,094	-
普通股持有人應佔虧損	(69,346)	(98,169)	-29.4%	(30,289)	128.9%
毛利率	0.8%	-4.8%		7.2%	
經營利潤率	-29.9%	-35.3%		-3.5%	
每股普通股股份淨虧損－基本 <sup>(1)</sup>	(0.00)	(0.00)		(0.00)	
每股美國預托股股份淨虧損－基本	(0.16)	(0.22)		(0.08)	
每股普通股股份淨虧損－攤薄 <sup>(1)</sup>	(0.00)	(0.00)		(0.00)	
每股美國預托股股份淨虧損－攤薄	(0.16)	(0.22)		(0.08)	
付運晶圓（8吋等值） <sup>(2)</sup>	429,843	341,261	26.0%	431,660	-0.4%
產能使用率	87.3%	75.4%		90.5%	

附注：

(1) 基於二零零九年第三季加權平均普通股 22,368,000,000 股（基本）及 22,368,000,000 股（攤薄），二零零九年第二季 22,352,000,000 股（基本）及 22,352,000,000 股（攤薄），二零零八年第三季 18,612,000,000 股（基本）及 18,612,000,000 股（攤薄）

(2) 包括銅接連件

- 二零零九第三季總銷售額由二零零九年第二季的 267,400,000 元上升至 323,400,000 元，錄得季度升幅 26.0%，是由於晶圓出貨量上升所致。

- 二零零九年第三季的銷售成本與二零零九年第二季的 280,300,000 元相比，上升 14.4% 至 320,700,000 元。
- 二零零九年第三季的毛利為 2,700,000 元，二零零九年第二季的毛利為負 12,900,000 元，二零零八年第三季的毛利為 27,200,000 元。
- 二零零九年第三季的毛利率由二零零九年第二季的負 4.8%改善至正 0.8%主要由於出貨量增加和產能使用率上升所致。
- 二零零九年第三季的總經營開支與二零零九年第二季的 81,600,000 元相比，錄得季度升幅 21.5%至 99,200,000 元主要由於一般行政費用增加所致（如下解釋）。
- 二零零九年第三季的研發費用與二零零九年第二季的 48,500,000 元相比，錄得季度升幅 3.2%至 50,000,000 元，主要由於 45 納米研發活動的費用增加所致。
- 二零零九年第三季的一般行政費用與二零零九年第二季的 17,200,000 元相比上升至 31,900,000 元，是由於律師費用增加所致。
- 二零零九年第三季的銷售費用由二零零九年第二季的 6,900,000 元上升至 7,700,000 元，錄得季度升幅 11.4%。
- 二零零九年第三季的所得稅利益由二零零九年第二季的 2,900,000 元大幅增加至 31,700,000 元是由於部分子公司的所得稅率改變帶來的遞延所得稅資產大幅增加所致。

## 收入分析

銷售分析			
以應用分類	二零零九年 第三季度	二零零九年 第二季度	二零零八年 第三季度
電腦	5.3%	4.3%	5.4%
通訊	46.7%	53.5%	53.0%
消費	41.9%	36.1%	32.8%
其他	6.1%	6.1%	8.8%
以服務分類	二零零九年 第三季度	二零零九年 第二季度	二零零八年 第三季度
邏輯 <sup>(1)</sup>	90.1%	90.9%	87.4%
記憶	4.0%	2.7%	2.3%
光罩製造，探測及其它	5.9%	6.4%	10.3%
以客戶類別分類	二零零九年 第三季度	二零零九年 第二季度	二零零八年 第三季度
非廠房半導體公司	67.3%	65.1%	55.1%
集成裝置製造商	16.1%	18.2%	26.1%
系統公司及其它	16.6%	16.7%	18.8%
以地區分類	二零零九年 第三季度	二零零九年 第二季度	二零零八年 第三季度
北美洲	59.2%	61.4%	58.6%
大中國 <sup>(2)</sup>	36.6%	33.2%	31.2%
亞洲 <sup>(3)</sup>	2.9%	3.9%	5.5%
歐洲	1.3%	1.5%	4.7%
晶圓收入分析			
各技術佔晶圓銷售額的百分比	二零零九年 第三季度	二零零九年 第二季度	二零零八年 第三季度
65 納米	0.5%	0.1%	0.0%
90 納米	15.8%	16.6%	19.4%
0.13 微米	36.5%	29.7%	25.1%
0.15 微米	2.6%	1.5%	2.0%
0.18 微米	27.8%	29.8%	33.9%
0.25 微米	0.6%	0.5%	0.5%
0.35 微米	16.2%	21.8%	19.1%

附注：

- (1) 包括 0.13 微米銅接連件
- (2) 包括香港和臺灣
- (3) 不包括大中國區

- 二零零九年第三季度來自於大中國區的晶圓收入成長 33.5%。
- 我們預期 65 納米邏輯晶圓的出貨量在二零零九年第四季度及二零一零年進一步增加。
- 0.13 微米及以下先進技術晶圓收入於二零零九年第三季佔總晶圓收入的 52.8%，二零零九年第二季為 46.4%。

產能\*

廠／（晶圓尺寸）	二零零九年 第三季度	二零零九年 第二季度
上海廠（8吋）	88,000	88,000
北京廠（12吋）	42,750	40,500
天津廠（8吋）	34,300	34,300
每月晶圓裝配總產能	165,050	162,800

附注：

(1) \*期終每月晶圓計8吋等值

付運及使用率：

8吋等值晶圓	二零零九年 第三季度	二零零九年 第二季度	二零零八年 第三季度
付運晶圓（包括銅接連件）	429,843	341,261	431,660
使用率 <sup>(1)</sup>	87.3%	75.4%	90.5%

附注：

(1) 產能使用率按輸出品圓總額除以估計產能計算

- 二零零九年第三季晶圓付運數量較二零零九年第二季的341,261片8吋等值晶圓增加26.0%至429,843片8吋等值晶圓，較二零零八年第三季度的431,660片8吋等值晶圓錄得年度降幅0.4%。

## 2. 詳細財務分析

### 毛利分析

以千美元計	二零零九年 第三季度	二零零九年 第二季度	季度比較	二零零八年 第三季度	年度比較
銷售成本	320,702	280,319	14.4%	348,721	-8.0%
折舊	155,949	146,763	6.3%	165,641	-5.9%
其他製造成本	157,843	126,655	24.6%	176,329	-10.5%
遞延成本攤銷	5,886	5,886	0.0%	5,886	0.0%
股權報酬	1,024	1,015	0.9%	865	18.4%
毛利（虧損）	2,654	(12,897)	-	27,224	-90.3%
毛利率	0.8%	-4.8%		7.2%	

- 二零零九年第三季的銷售成本與二零零九年第二季的 280,300,000 元相比，上升 14.4% 至 320,700,000 元。
- 二零零九年第三季的毛利為 2,700,000 元，二零零九年第二季的毛利為負 12,900,000 元，二零零八年第三季的毛利為 27,200,000 元。
- 二零零九年第三季的毛利率由二零零九年第二季的負 4.8% 改善至正 0.8% 主要由於出貨量增加和產能使用率上升所致。

### 經營開支分析

以千美元計	二零零九年 第三季度	二零零九年 第二季度	季度比較	二零零八年 第三季度	年度比較
總經營開支	99,184	81,606	21.5%	40,451	145.2%
研究及開發	50,003	48,450	3.2%	17,838	180.3%
一般及行政	31,922	17,196	85.6%	10,761	196.7%
銷售及市場推廣	7,693	6,905	11.4%	5,578	37.9%
無形資產攤銷	9,535	8,858	7.6%	6,906	38.1%
資產處置損失（收入）	29	197	-85.3%	(632)	-

- 二零零九年第三季的總經營開支與二零零九年第二季的 81,600,000 元相比，錄得季度升幅 21.5% 至 99,200,000 元主要由於一般行政費用增加所致。
- 二零零九年第三季的研發費用與二零零九年第二季的 48,500,000 元相比，錄得季度升幅 3.2% 至 50,000,000 元，主要由於 45 納米研發活動費用增加所致。
- 二零零九年第三季的一般行政費用與二零零九年第二季的 17,200,000 元相比上升至 31,900,000 元，是由於律師費用增加所致。

- 二零零九年第三季的銷售費用由二零零九年第二季的 6,900,000 元上升至 7,700,000 元，錄得季度升幅 11.4%。

### 其他收入（支出）

以千美元計	二零零九年 第三季度	二零零九年 第二季度	季度比較	二零零八年 第三季度	年度比較
其他收入（支出）	(3,943)	(5,802)	-32.0%	(15,631)	-74.8%
利息收入	634	635	-0.2%	2,542	-75.1%
利息支出	(7,941)	(8,386)	-5.3%	(11,088)	-28.4%
匯兌收益（虧損）	2,441	219	1014.6%	(7,023)	-
其他，淨額	923	1,730	-46.6%	(62)	-

- 合併來自於經營性活動的匯兌損益，公司於二零零九年第三季整體錄得匯兌虧損 500,000 元，二零零九年第二季錄得匯兌虧損 800,000 元。

### 折舊及攤銷

- 二零零九年第三季的折舊及攤銷總額為 198,900,000 元，相較於二零零九年第二季的 202,900,000 元。

### 流動資金

以千美元計	二零零九年 第三季度	二零零九年 第二季度
現金及現金等價物	453,285	435,613
限制性現金	20,071	22,580
短期投資	6,110	3,313
應收賬款	194,202	161,181
存貨	186,839	183,012
其他	25,896	18,877
流動資產總計	886,403	824,575
應付賬款	175,170	166,699
短期借款	281,243	273,678
長期借款的即期部份	249,395	205,344
其他	142,596	144,726
流動負債總計	848,404	790,447
現金比率	0.5x	0.5x
速動比率	0.7x	0.7x
流動比率	1.0x	1.0x

## 資本結構

以千美元計	二零零九年 第三季度	二零零九年 第二季度
現金及現金等價物	453,285	435,613
限制性現金	20,071	22,580
短期投資	6,110	3,313
長期票據即期部分	29,493	29,242
長期票據	9,582	9,500
短期借款	281,243	273,678
長期借款的即期部份	249,395	205,344
長期借款	573,697	615,999
總借款	1,104,335	1,095,021
股東權益	2,411,556	2,478,322
總債務股本比率	45.8%	44.2%

## 現金流量概要

以千美元計	二零零九年 第三季度	二零零九年 第二季度
來自於經營活動的現金淨額	72,954	43,198
來自於投資活動的現金淨額	(64,555)	(27,353)
來自於融資活動的現金淨額	9,380	(82,191)
現金變動淨額	17,672	(66,403)

## 資本開支概要

- 二零零九年第三季資本開支為 52,600,000 元。
- 二零零九年預期的資本開支總額將約為 190,000,000 元。

## 近期公佈

- 中芯國際在 65 奈米和 45 奈米 CMOS 邏輯工藝選擇 Kilopass OTP 嵌入式非揮發性記憶體矽智財 (NVM) 解決方案 (二零零九年九月二十五日)
- 中芯國際採用 Virage Logic 公司 AEON® 嵌入式 MTP NVM 於 RFID 應用 (二零零九年九月二十四日)
- 截止二零零九年六月三十日止六個月未經審核中期業績公佈 (二零零九年九月二十一日)
- 中芯國際發佈舉行於 2009 年 9 月 15 日的“分析師日”簡報 (二零零九年九月十八日)
- 董事會會議日期通知 (二零零九年九月四日)
- 選擇公司通訊之收取方式及語言版本 (二零零九年八月四日)
- 中芯截止二零零九年六月三十日止三個月業績公佈 (二零零九年七月二十八日)
- 中芯國際成功應用 130 奈米技術量產 DisplayLink 的 USB 圖像晶片 (二零零九年七月二十七日)
- 微捷碼宣佈推出支援 SMIC 65 奈米工藝的低功耗參考流程 (二零零九年七月二十日)
- 董事會會議日期通知 (二零零九年七月十日)

上述公佈詳情請參閱中芯網站。

[http://www.smics.com/website/enVersion/Press\\_Center/newsRelease.ftl](http://www.smics.com/website/enVersion/Press_Center/newsRelease.ftl)

合併資產負債表  
(美元)

截至以下日期止

	二零零九年 九月三十日 (未經審核)	二零零九年 六月三十日 (未經審核)
<b>資產</b>		
流動資產：		
現金及現金等價物	453,284,870	435,613,297
限定用途的現金	20,070,776	22,579,630
短期投資	6,110,231	3,312,592
應收賬款，已扣除撥備分別為 二零零九年九月三十日 6,509,798 元 及二零零九年六月三十日 5,637,336 元	194,202,163	161,181,170
存貨	186,839,459	183,011,768
預付款項及其它流動資產	25,895,689	18,876,474
<b>流動資產合計</b>	<b>886,403,188</b>	<b>824,574,931</b>
預付土地使用權	78,486,074	78,860,359
廠房及設備，淨額	2,478,950,867	2,625,371,271
購入無形資產，淨額	192,778,696	184,845,479
遞延成本，淨額	29,432,198	35,318,637
股權投資	9,962,419	10,275,172
其他長期預付款	551,535	825,389
長期應收款	131,205,267	131,072,053
遞延稅資產	93,163,395	57,250,700
<b>資產合計</b>	<b>3,900,933,639</b>	<b>3,948,393,991</b>
<b>負債及股東權益</b>		
流動負債：		
應付帳款	175,169,952	166,698,508
預提費用及其它流動負債	109,116,249	114,632,973
短期借款	281,242,502	273,678,075
長期票據的即期部份	29,492,873	29,242,001
長期借款的即期部份	249,395,373	205,343,559
應付所得稅	3,986,995	851,539
<b>流動負債合計</b>	<b>848,403,944</b>	<b>790,446,655</b>

長期負債：

長期票據	9,581,864	9,500,358
長期借款	573,696,518	615,998,747
與特許權協定相關的長期應付款	16,674,534	16,488,420
其他長期負債	6,000,000	3,000,000
遞延稅負債	453,205	335,577
<b>長期負債合計</b>	<b>606,406,121</b>	<b>645,323,102</b>

**負債合計** 1,454,810,065 1,435,769,757

非控制權益 34,567,186 34,302,529

股東權益：

普通股，面值 0.0004 元，法定股份為 50,000,000,000 股，

於二零零九年九月三十日及二零零九年六月三十日法定及已發行股份分別為 22,366,133,058 股及

22,353,411,672 股。 8,946,454 8,941,365

額外繳入股本 3,497,010,545 3,494,327,734

累計其他綜合（虧損）收入 (8,293) 98,945

累計虧絀 (1,094,392,318) (1,025,046,339)

**所有股東權益合計** 2,411,556,388 2,478,321,705

**總負債，非控制權益及股東權益合計** 3,900,933,639 3,948,393,991

合併營運報表  
(美元)

截至以下日期止三個月

	二零零九年 九月三十日 (未經審核)	二零零九年 六月三十日 (未經審核)
銷售額	323,355,915	267,422,419
銷售成本	320,702,261	280,318,656
<b>毛利(虧損)</b>	<b>2,653,654</b>	<b>(12,896,237)</b>
經營費用：		
研究和開發	50,003,000	48,450,248
一般及行政	31,922,632	17,195,574
銷售和市場推廣	7,693,241	6,904,892
購入無形資產攤銷	9,535,274	8,858,012
來自廠房設備和其他固定資產的銷售 損失	29,475	196,980
<b>經營費用總額</b>	<b>99,183,622</b>	<b>81,605,706</b>
<b>經營虧損</b>	<b>(96,529,968)</b>	<b>(94,501,943)</b>
其他收入(支出)：		
利息收入	633,879	634,737
利息支出	(7,941,202)	(8,386,025)
匯兌收益	2,441,374	219,319
其他, 淨額	923,152	1,730,404
<b>其他支出, 淨額</b>	<b>(3,942,797)</b>	<b>(5,801,565)</b>
<b>所得稅前虧損</b>	<b>(100,472,765)</b>	<b>(100,303,508)</b>
所得稅利益	31,704,196	2,880,291
股權投資虧損	(312,752)	(481,605)
<b>淨虧損</b>	<b>(69,081,321)</b>	<b>(97,904,822)</b>
非控制權益持有人利息	(264,658)	(261,781)
<b>中芯國際應佔虧損</b>	<b>(69,345,979)</b>	<b>(98,166,603)</b>

每股股份淨虧損，基本及攤薄	(0.0031)	(0.0044)
每股美國預托股份淨虧損，基本及攤薄	(0.1550)	(0.2196)
用作計算基本及攤薄每股普通股 虧損額的股份	22,368,419,207	22,352,477,317

合併現金流量表  
(美元)

截至以下日期止三個月

	二零零九年 九月三十日 (未經審核)	二零零九年 六月三十日 (未經審核)
<b>經營活動:</b>		
<b>淨虧損</b>	<b>(69,081,321)</b>	<b>(97,904,822)</b>
<b>淨虧損至經營活動所得(所耗)現金淨額對賬的調整:</b>		
遞延稅	(35,795,067)	(5,319,471)
處置設備及其它長期資產損失	29,475	196,980
折舊及攤銷	186,777,756	191,368,626
長期票據及與特許權協定相關的長期應付款的非現金利息費用	736,747	992,974
購入無形資產攤銷	9,535,274	8,858,012
股權報酬	2,622,067	2,630,178
股權投資虧損	312,752	481,605
<b>營運資產及負債的變動:</b>		
應收賬款, 淨額	(33,020,992)	(77,071,568)
長期應收款	(133,214)	(4,966,252)
存貨	(3,827,691)	(28,228,273)
預付款及其它流動資產	(6,745,362)	6,474,752
應付賬款	(1,498,671)	39,046,117
預提費用及其它流動負債	16,907,154	3,255,592
其他長期負債	3,000,000	3,000,000
應付所得稅	3,135,456	383,671
<b>經營活動所得現金淨額</b>	<b>72,954,363</b>	<b>43,198,121</b>
<b>投資活動:</b>		
購入廠房、設備	(51,439,333)	(44,759,433)
政府授予購買廠房及設備所得款項	19,692,334	14,544,928
出售設備所得款項	779,075	(191,827)
出售待售資產所得款項	-	(26,201)
購買所獲無形資產	(33,298,688)	(2,987,788)

購買短期投資	(6,027,164)	(5,648,618)
出售短期投資	3,229,525	23,067,587
轉換限定用途的現金	2,508,855	(11,351,889)
<b>投資活動所耗現金淨額</b>	<b>(64,555,396)</b>	<b>(27,353,241)</b>
<b>融資活動：</b>		
短期借款所得款項	153,106,179	215,404,493
償還短期借款支付的款項	(145,541,751)	(211,804,669)
長期借款所得款項	51,749,585	-
償還長期借款支付的款項	(50,000,000)	(70,827,750)
償還票據支付的款項	-	(15,000,000)
行使雇員購股權所得款項	65,832	37,245
<b>融資活動所得(所耗)現金淨額</b>	<b>9,379,845</b>	<b>(82,190,681)</b>
匯率變動的影響	(107,239)	(56,759)
<b>現金及現金等價物增加(減少)淨額</b>	<b>17,671,573</b>	<b>(66,402,560)</b>
<b>現金及現金等價物－期間開始</b>	<b>435,613,297</b>	<b>502,015,857</b>
<b>現金及現金等價物－期間結束</b>	<b>453,284,870</b>	<b>435,613,297</b>

於本公告日期，本公司董事分別為董事會主席兼獨立非執行董事江上舟先生、本公司總裁兼首席執行官兼執行董事張汝京先生、本公司非執行董事陳山枝先生、高永崗先生及周杰先生（及周杰先生的替任董事汪正綱先生），以及本公司獨立非執行董事川西剛先生、陳立武先生。

承董事會命  
中芯國際集成電路製造有限公司  
張汝京  
首席執行官

中國上海

二零零九年十月二十八日

\* 僅供識別